



eSurface の工程で不可能を可能に

革新的な方法でほとんどの表面、形、サイズのものにプリント配線板や電子部品を製造することができます。

“プリント配線板産業での40年間以上の経験を通して、これほど画期的なプロセスを見たのは初めてでした。”

スコット・マッカーディ氏
Freedom CAD Services 営業部長

主な利点

- 製造工程を75%削減
- 生産性の向上
- 廃棄物の削減
- より小さく、薄く、軽く、早い基板の製造
- アンダーカット(溝、へこみ)なしで形成
- 無制限の形に適用可能

“eSurfaceの工程を使用して、微細配線、スペースの質を上げ、生産性を今までに見たことのないまでに上げることができました。”

ケン・バール氏
Sierra Circuits設立者、CEO
(eSurfaceを使用した最初のプリント配線板製造者)

お問い合わせ先:

米国: rachel@esurface.com
日本: info@esurface.co.jp



製品のトータルなソリューションをご提供いたします! www.esurface.co.jp